

高导银胶，纳米银胶，大功率银胶，航天**银胶

产品名称	高导银胶，纳米银胶，大功率银胶，航天**银胶
公司名称	前海吉轩电子（深圳）有限公司
价格	4200.00/罐
规格参数	科美克:美国 KM1901:大功率银胶 美国:KMARKED
公司地址	广东 深圳市宝安区 福永镇财富大厦3A11室
联系电话	0755-33123275 13530819587

产品详情

KM1901HK EPOXY ADHESIVE PASTE

专业高导热无铅银胶

一. 产品描述

K M 1 9 0 1 H K 是一种具有高导电高导热性的固晶胶，

单组份，粘度适中，常温储存时间长，操作方便。它是

一种专门为细小的部件和类似于大功率LED 粘接固定芯片

应用而开发设计的新产品。该产品对分配和粘接大量部件

时具有较长时间的防挥发、耐干涸能力，并可防止树脂在

加工前飞溅溢出，与同类型的其他品牌掺银粘接剂相比，

K M 1 9 0 1 H K 系列能在室温情况运输。

二. 产品特点

具有高导热性：高达 55W/m-k

非常长的开启时间

替换焊接剂 - 消除了铅 (Pb) 金属与电镀要求

电阻率低至 $4.0 \mu \Omega \cdot \text{cm}$

室温下运输与储存 - 不需要干冰

对调配与/或丝网印刷具有优良的流动性

极微的渗漏

三 . 产品应用

此银胶推荐应用在大功率设备上，例如：

大功率 LED 芯片封装

功率型半导体

激光二极管

混合动力

RF 无线功率器件

砷化镓器件

单片微波集成电路

替换焊料

四 . 典型特性

物理属性：

25 粘度，kcps 千周(秒) @10 rpm(每分钟转数)，

#度盘式粘度计: 30

触变指数，10/50 rpm@25 : 2.2

保质期：0 保 6 个月, -15 保 12 个月

银重量百分比: 85%

银固化重量百分比 : 89%

密度 , g/cc : 5.5

加工属性(1) :

电阻率 : μ .cm : 4

粘附力/平方英寸(2) : 3800

热传导系数 , W/moK 55*

热膨胀系数 , ppm/ 26.5*

弯曲模量, psi 5800*

离子杂质 : Na+,Cl-,K+,F-, ppm<15

硬度 8 0

冲击强度 大于 1 0 K G / 5 0 0 0 p s i

瞬间高温 2 6 0

分解温度 3 8 0

五 . 储存与操作

此粘剂可装在瓶子里无须干冰。当收到物品后 , 室温下储存在 1 - 5rpm 的罐滚筒里**。未能充分摇晃将导致非均匀性与不一致的调配。若没有摇晃 , 在使用前宜慢慢搅动。须冷冻储存。如果粘剂是均匀的 (即在顶部没有溶解或在瓶子底部无粘稠固体) , 可以立即倒入针筒 (灌注器) 里使用。本产品同样也可包装在针筒里 , 并且可以在负 40度温度下运输。更多信息请参考 “ 粘剂的针筒包装 ” 文件。

六 . 加工说明

应用KM1901HK的流动性通过利用自动高速流动设备而无拉尾与滴落现象产生。在使用前应无气泡产生 , 在材料应用与组件放置期间能提供几个小时的开启时间。这对用在小组件当中很重要。推荐用 22 号针头 (16 密耳) 调配 KM1901HK。而小于 25 号 (10 密耳) 的针头可能不能产生一致的调配重量。

对于较大的晶片应把粘剂调配成 X 形状。按照部件的大小沉积重量可能有所不同。典型的调配数量是粘接面积的每平方英寸75微升或290毫克。晶片应与粘剂 KM1901HK完全按压，在围绕周边形成银胶围高，使得湿沉积有 1.3 至 1.9 密耳的厚度，*终固化银胶厚度应接近在0.8至 1.2个密耳间。

七．固化介绍

对于较小的粘接面积（小于 0.250 英寸），无需预烘烤。较大的粘接部位需要在固化循环前进行预干燥。把材料放置在简易通风的地方，在室温下利用空气强制对流，并设置所要的温度，如果使用带式炉或其它类型的烤箱，升温率应当控制在理想的结果内。以下为升温率，时间与温度的推荐值适合小于 0.4 英寸方形面积（10mm）的部件，相关值见下表：粘接面积>0.250-0.400 英寸的预烤（如适用可选择以下的其中一种方式）

峰值温度	升温率	烘烤时间
100 度	5 - 10 度/每分钟	75 分钟
110 度	5 - 10 度/每分钟	60 分钟
125 度	5 - 10 度/每分钟	30 分钟

粘接面积 0.4 尺寸的固化（可选择以下的其中一种方式）

峰值温度	升温率	固化时间
175 度	5 - 10 度/每分钟	45 分钟
200 度	5 - 10 度/每分钟	30 分钟
225 度	5 - 10 度/每分钟	15 分钟